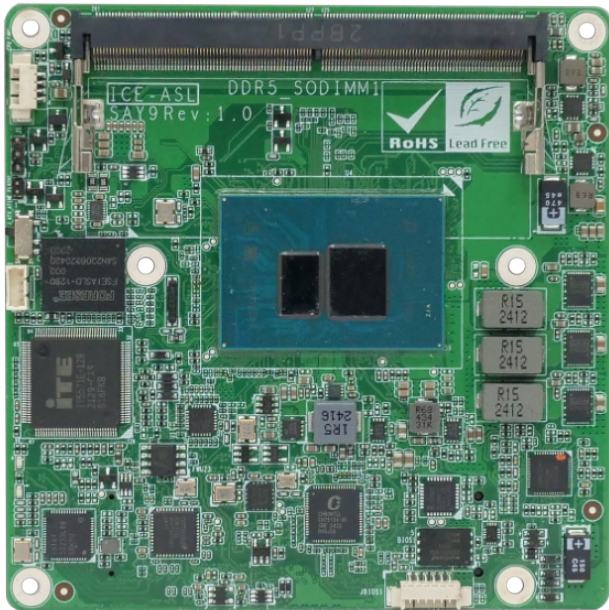


ICE-ASL-T6C

COM Express® R3.1 Type 6 Module 支持 Intel® Amston Lake Atom™ x7000 系列 SoC 处理器



Features

- » COM Express® R3.1 Type 6 Module 支持 Intel® Amston Lake Atom™ x7000 系列 SoC 处理器
- » 1 x DDR5 4800 SO-DIMM, 高达 16GB
- » 三重独立显示信号连接至底板
 - 1 x LVDS: 1920 x 1080 or 1 x eDP:4096 x 2304 @ 60Hz
 - 2 x DDI: (DP up to 4096 x 2160 @ 60Hz / HDMI up to 4096 x 2160 @ 60Hz)
- » 支持 1 x PCIe 2.5 GbE with Intel® i226-V信号连接至底板

Specifications

| | |
|-----------------|--|
| 尺寸类型 | |
| 尺寸类型 | COM Express® R3.1 Type 6 Module Compact size |
| 系统 | |
| CPU | Intel® Amston Lake Atom™ x7000 系列 SoC 处理器 |
| | Intel Atom® x7433RE on-board CPU |
| | Intel Atom® x7835RE on-board CPU |
| 内存 | 1 x DDR5 4800 SO-DIMM |
| 内存上限 | 高达 16GB |
| 散热方案/系统风扇 | 1 x CPU fan connector (1x4 pin) |
| | 1 x System fan connector (1x4 pin) |
| 物理特性 | |
| 尺寸 (LxWxH) (mm) | 95 x 95 mm |
| 净重 | GW: 600g / NW: 250g |
| 存储 | |
| 存储 | 2 x SATA : 3GB/s signal to base board |
| | onboard eMMC optional (up to 256G) |
| I/O 接口 | |
| 显示输出 | 1 x HDMI™ : 显示信号连接至底板, 高达 4096 x 2160 @ 60Hz |
| | 1 x Display Port : 显示信号连接至底板, 高达 4096 x 2160 @ 60Hz |
| | 1 x LVDS : 显示信号连接至底板, 高达 1920 x 1080 或者 1 x eDP 显示信号连接至底板, 高达 4096 x 2304 @ 60Hz |
| 网络 | 1 x LAN : PCIe 2.5 GbE with Intel® i226-V 信号连接至底板 |
| 音频 | 1 x HD Audio : 信号连接至底板 |
| I/O接口 | 8 x 内部 USB 2.0 : 信号连接至底板 (one colay with CAN) |
| | 1 x CAN-bus/OBD-II : 信号连接至底板(Default, Option with one COM Port & one USB 2.0) |
| | 3 x Internal USB 3.2 Gen2x1 : 信号连接至底板 |
| | 1 x I ² C : 1 x 4-pin wafer 信号连接至底板 |
| | 1 x GPIO : 8 bit GPIO 信号连接至底板 |
| | 2 x UART : 信号连接至底板 |

| | |
|----------------|-------------------------------|
| 扩展 | 5 x PCIe x1 : Gen3 x1 信号连接至底板 |
| Other Features | |
| TPM | 1 x On-board TPM |
| 电源 | |
| 电源功耗 | TBD |
| 电源供电 | ATX: Vin, VSB; AT: Vin |
| | 12 V power input |
| 环境 | |
| 操作温度 | -10°C ~ 65°C |
| 存储温度 | -30°C ~ 70°C |
| Humidity | 5% ~95%, 无冷凝 |

Ordering Information

| | |
|--------------------|---|
| ICE-ASL-T6C-R4-R10 | COM Express Compact size Type 6 Module, Intel® ASL x7835RE Processor,DDR5, LVDS, DDI, 2.5GbE, SATAIII, USB 3.0 and HD Audio, RoHS |
| ICE-ASL-T6C-R3-R10 | COM Express Compact size Type 6 Module, Intel® ASL x7433RE Processor,DDR5, LVDS, DDI, 2.5GbE, SATAIII, USB 3.0 and HD Audio, RoHS |
| ICE-ASL-T6C-N2-R10 | COM Express Compact size Type 6 Module, Intel® ADL N97 Processor,DDR5, LVDS, DDI, 2.5GbE, SATAIII, USB 3.0 and HD Audio, RoHS |

Packing List

| | |
|----------------|----------|
| 1 x ICE-ASL 单板 | 1 x 散热模块 |
| 1 x 螺丝包 | 1 x QIG |